



Deep Flash Forensik

Tauchen, umwandeln, auswerten

ACATO GmbH
Christian Bartsch
(CFE, SV f. ITF, MCT, MCSE+I)



ACATO GmbH

Hauptsitz in München (neben KPMG und WKGT)

Service Portfolio:

- IT Forensik (Handy, PC & Fraud Investigations)
- Entwicklung eigener F-Tech Lösungen
 - Software f
 ür Renditeberechnung bei Beteiligungen
 - Software für Fall Management
 - Name Profiling Software
 - Crypt Cleaner Software
- Präventionsberatung
- Datenrettung (mit eigenem Class 100 Reinraum)
- Distribution von forensischer Ausrüstung



Rahmensituation

- Ohne Chip-off ist ein Auslesen kaum noch möglich
- Sicherheitsblockaden verhindern JTAG Methoden
- BGA und eMMC Chips werden zum Problem:
 - Komplexe Signal- und Versorgungswege (Pinout => Verkabelung im 0.05mm Bereich)
 - empfindlicher (Gefahr der Beschädigung im Entnahmeprozess)
 - Anfälligkeit für teilweiser/vollständiger Totalausfall





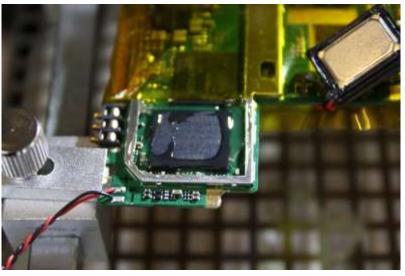
Acer z520 mit eMMC/MCP -> DRAM + Flash mit 221 BGA Aufbau



Was befindet sich im Speicher?

- Datenbereiche
- ECC oder BCH Codes
- XOR Keys
- Service Area
 - LBN, LPN,
 - Header,
 - Block Number
 - Plane Number
- Steuerungsdaten
- Ungenutzte Bereiche
- Sonstiges

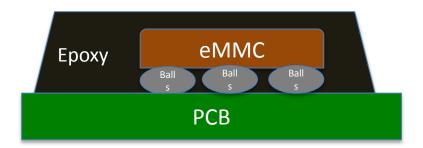
S5 mini

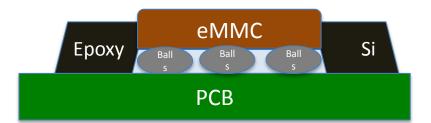




Welche Speichertypen dominieren?

- TSOP-48 bald nicht mehr dominieren außer in billigen Geräten
- BGA ohne integriertem Controller in Mid-Range Bereich
- eMMC wird in den nächsten Jahren in fast allen Geräten vorkommen!
- MCPs sind im kommen (stromsparende Kombi aus DRAM und Flash Speicher)
- eMMC und BGA Chips immer häufiger mit Epoxy vor Rissen geschützt
- eMMC mit Silikon umrahmt als weniger komplexer Schutz

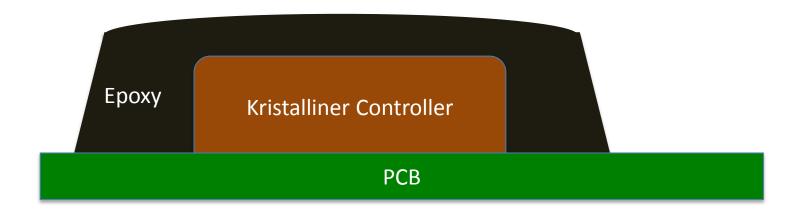






Probleme im Chipoff

- Überhitzung beim Ausbau
- Fehlender Support durch gängige Systeme
- Fehlende Informationen über den Pin-Layout
- Nicht lesbare Controller Kennzeichnung
- Integrierte Controller (eventuell auch defekt)





Herausforderungen

Die Chip-off Forensik erfordert zunehmend...

- Unbekannte Strukturen zu rekonstruieren.
- Schäden im Chip zu überwinden
- Schneller auf dem aktuellsten Stand zu sein
- Mehr Flexibilität in der eigenen Arbeit



Was brauchen wir für diese Aufgabe

- Chipreader
- Visual Nand Reconstruction Software
- Rework Station mit Dark Infrared
- PC gesteuerte Lötstation
- Mikroskop mit x40+ Zoom
- Analysetool für Handy Daten



Ausbau und Lösen der Chips

- Verwendung von IR bei BGA Chips
- Auslöten von TSOP48 mit Speziallötkolben
- Epoxy BGA Chips bei spezieller Temperatur auslösen

Auch der Ausbau aus dem Gerät sollte möglichst schmerzfrei für die Platine erfolgen.

Rework erfolgt anhand von internen Temperaturtabellen

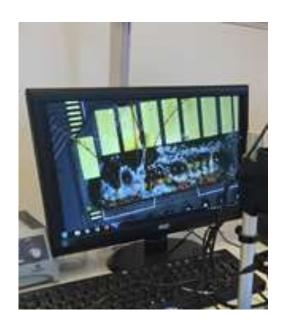


Wege zum Auslesen

Adapter vs. Feinlöten

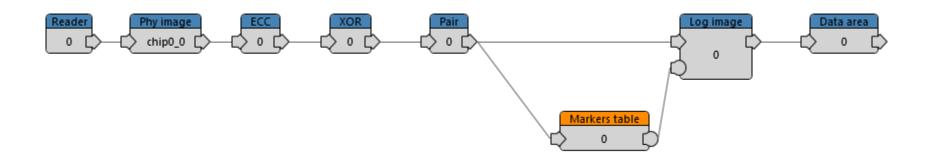
- Es gibt nur wenige Adapter für diverse BGA Typen
- Hohe Abnutzungserscheinungen bei Adaptern
- Adapter schon nach 5 Einsätzen beschädigt
- Preis und Qualitätsunterschiede der Adapter

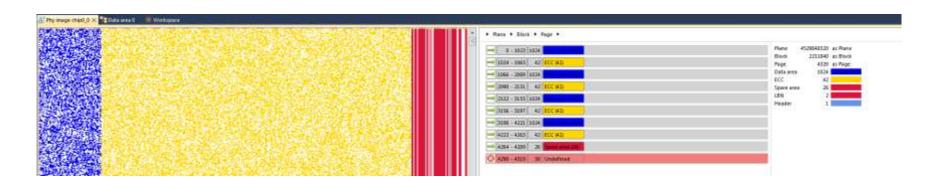
Manufaktur wird weiterhin überwiegen





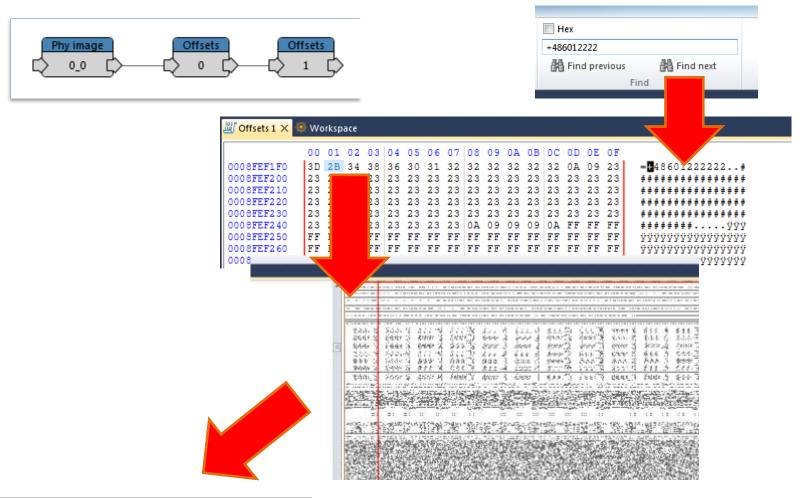
Wie sieht die Arbeit aus?







Beispiel – Sony Ericsson mit BGA137



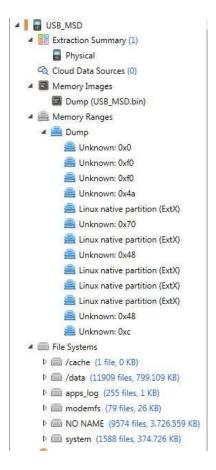
Byte position: 220; Row: 71657; Address: 151339804; Value: 11



Samsung Smartphones

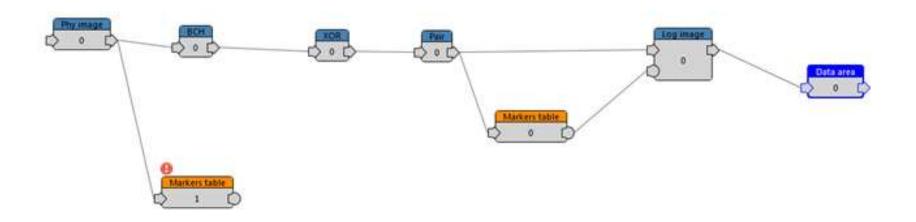
Chipoff ist bei nicht eingeschalter Verschlüsselung möglich!

z.B. S4, S Duo, S5, ...



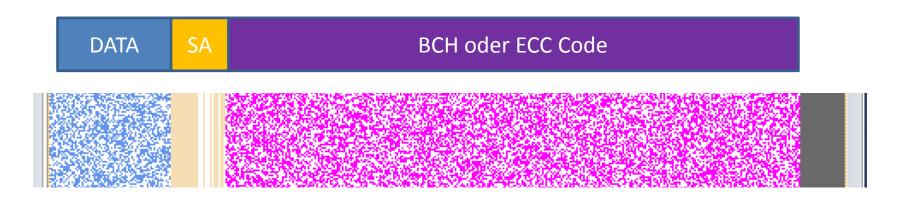


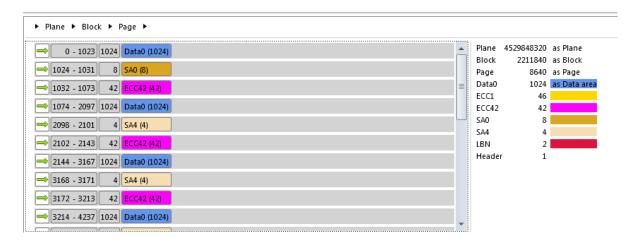
Von der Analyse zum Ergebnis





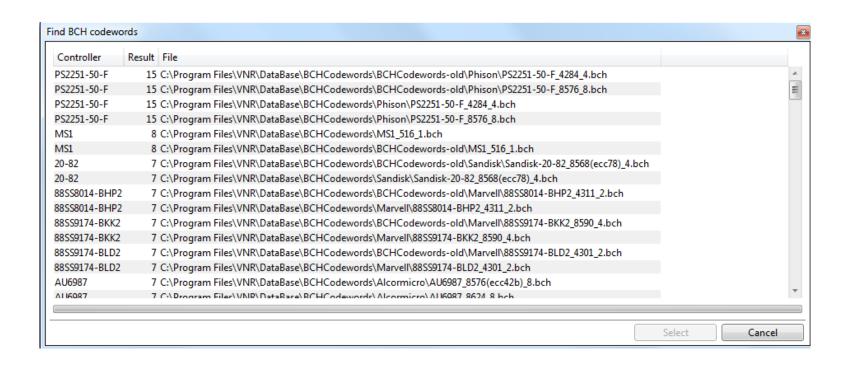
Analyse des Dumps





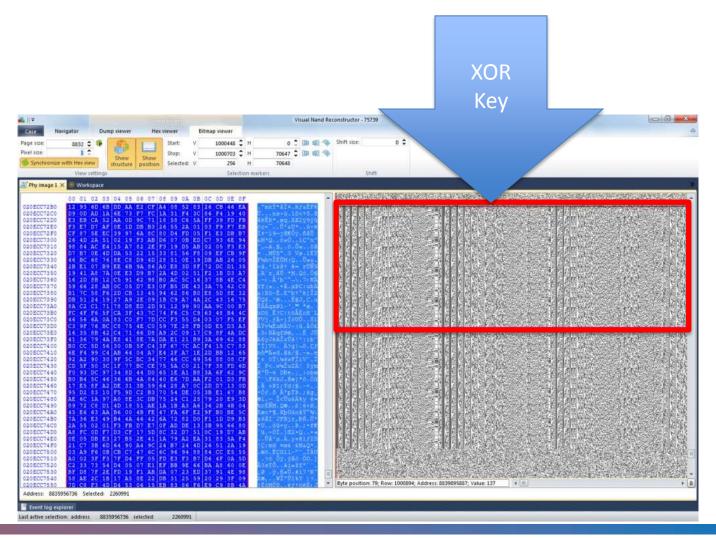


BCH Code finden oder recherchieren





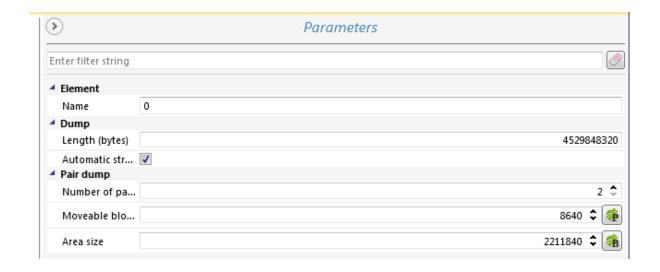
XOR Key anwenden oder erarbeiten





Pair – Raid O Daten zusammenführen

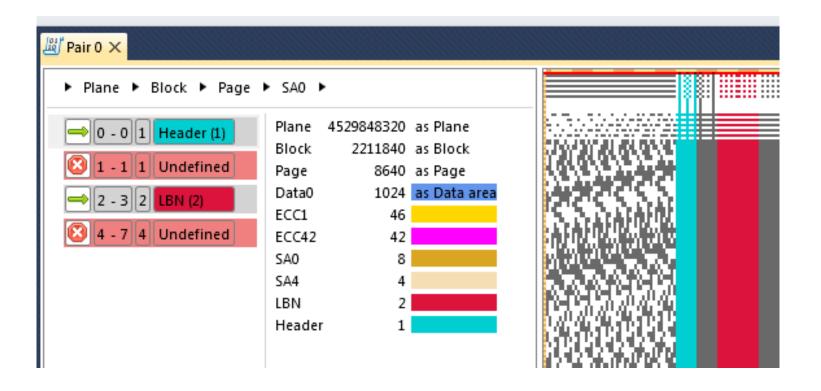






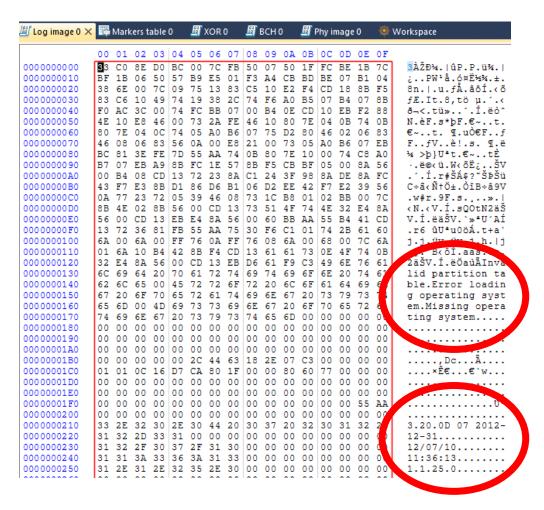
Markers Table

Header sowie LBN finden und kennzeichnen





Logical Image



Daten werden auch in Hex lesbar

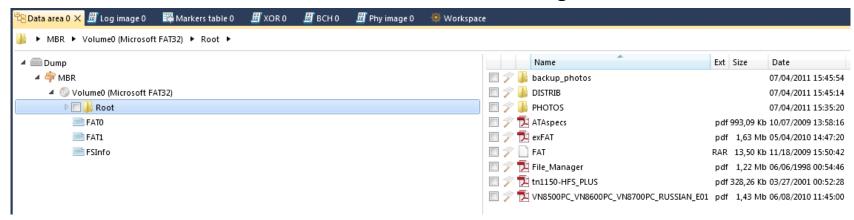
und

sind nicht mehr zerstückelt

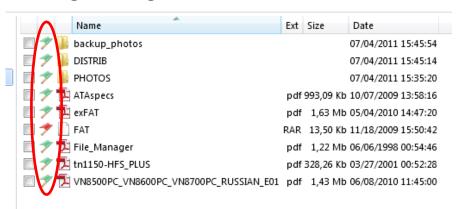


Dump Folder Structure

Am Ende können Dateien und Verzeichnisse sichtbar gemacht werden.



Auch eine Header Prüfung ist möglich

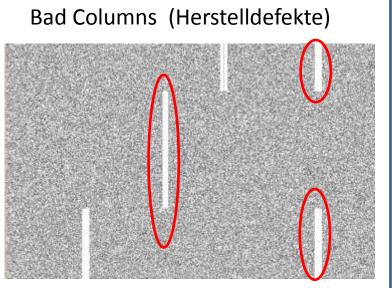




Problemlösungen

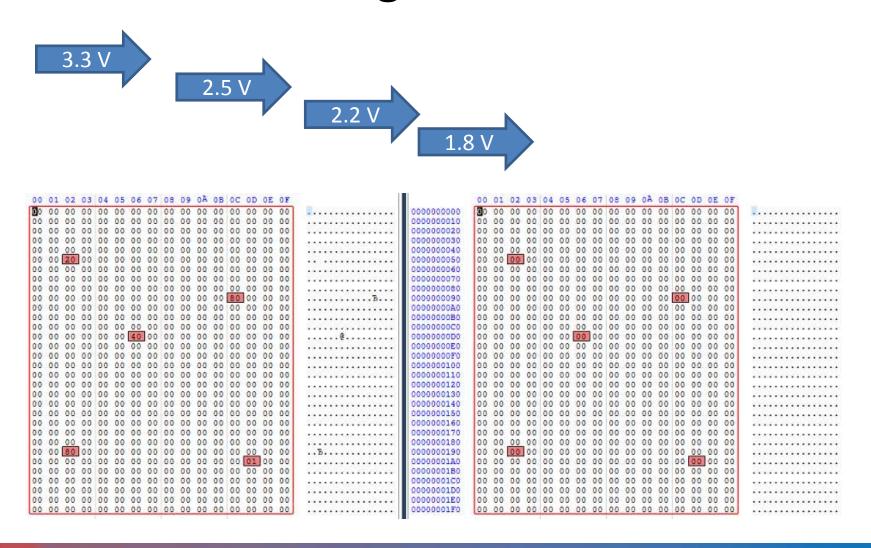
- Strom und/oder Geschwindigkeit senken
- Fehlerhafte Bereiche kennzeichnen und ausfiltern
- Serielle oder Parallele Datenbereiche sortieren
- Uvm.







Flexible Einstellung senkt Datenfehler

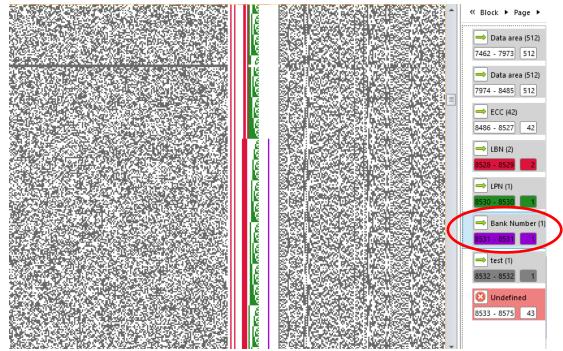




Bank Number

90% der Controller verwenden keine Bank Nummer.

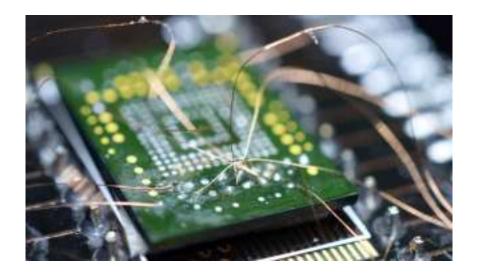
Die anderen 10% der Controller lassen sich auch mit VNR lösen:



Damit können Block Filtering und Translation Tabellen aufgebaut werden



Aufwendige Verkabelungen



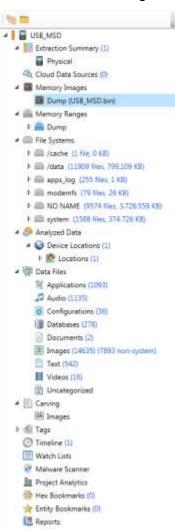


Interpretation von Chip Dumps

Dumps muss man analysieren und umwandeln für weitere forensische Auswertung.



Dennoch gibt es stets Risiken und Anomalien.





Was kann man untersuchen?

- Mobiltelefone (TSOP, BGA-224)
- Smartphones (BGA-136/137, BGA-169eMMC [5 Größen], MCP169/221)
- Speicherkarten (TSOP48, BGA52/100/132/152/154, Monolithic)
- USB Sticks (TSOP48, BGA, Monolithic)
- SSD Festplatten (TSOP-48/56, iNAND, eMMC)
- Geräte mit integriertem Flashspeicher (Diktiergeräte, Kameras...)
- Digitale Fahrtenschreiber
- Flugschreiber mit SLC Chips
- Sonstiges



Vielen Dank

Christian Bartsch

Geschäftsführer



ACATO GmbH Heimeranstraße 37 80339 München

Tel. 089 / 540 41 07 - 0

www.acato.de